

МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПЛЕНОК $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ ПУТЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА

И.Н. Трапезникова, О.И. Коньков, Е.И. Теруков, С.Г. Ястребов

В работах, посвященных исследованиям структурных, оптических и электрофизических свойств гидрированного аморфного карбида кремния $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ ($0 < x < 1$), показано, что с ростом x — количества углерода в пленке — резко увеличивается плотность структурных дефектов, таких как оборванные связи и микропоры [1], отрицательно влияющих на транспортные и оптические свойства [2]. Роль водорода при этом заключается в пассивации оборванных связей, что решающим образом влияет на физические свойства пленок. В свою очередь встраивание водорода и его поведение в материале сильно зависит от условий выращивания пленки и отжига [3–5]. В работе [6] было показано, что в результате отжига пленок $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ в вакууме при температурах до 400°C происходит структурная перестройка материала, сопровождающаяся значительным уменьшением концентрации оборванных связей.

Нами исследовались структурные изменения, происходящие в пленках $a\text{-Si}_{0.5}\text{C}_{0.5}\text{:H}$, т.е. состава, близкого к стехиометрическому, при отжиге в высоком вакууме и в водородной плазме в температурном интервале 250 – 800°C .

Пленки были получены высокочастотным разложением газовых смесей ($\text{SiH}_4 + \text{CH}_4/\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2/\text{Ar}$) в условиях, описанных в [6]. Режимы выдержки в водородной плазме (40 MHz, 0.2 Torr) выбирались таким образом, чтобы провести полный динамический отжиг разупорядоченностей аморфной сетки с учетом диффузии водорода в материале.

1. Методика эксперимента

Состав пленок определялся с помощью Оже-спектроскопии и метода рентгеновского спектрального анализа. Характер химических связей входящих в состав пленок атомов и их концентрации оценивались с помощью ИК-спектроскопии. Показатели преломления пленок n определялись эллипсометрическим методом [7]. Оптическая ширина запрещенной зоны E_g^{opt} определялась экстраполяцией зависимости

$$(\alpha h\nu)^{1/2} = Bf(h\nu - E_g^{\text{opt}})$$

до пересечения с осью абсцисс, α — коэффициент поглощения, B — коэффициент пропорциональности в данной зависимости [1].

Концентрация спинов N_s оценивалась по данным электронного paramagnитного резонанса. Аморфность/кристалличность структуры пленок контролировалась с помощью метода дифракции рентгеновских лучей. Электрические свойства пленок оценивались по их электропроводности или в некоторых случаях по изменению диодных характеристик на барьерах $c\text{-Si}-a\text{-SiC:H:Pd}$.

2. Экспериментальные результаты

Результаты температурного отжига пленок приведены на рис. 1. В соответствии с данными исследований эфузии водорода из пленок $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ [4] и дифференциальной калориметрии [3] исследуемый температурный диапазон отжига может быть условно разделен на три интервала.

1) Температура отжига $T_A = 250\text{--}350^\circ\text{C}$. В этом температурном диапазоне все измеряемые характеристики слабо меняются, причем отсутствуют различия между отжигом в вакууме и в водородной плазме. Как было показано в [3], при этих температурах происходит релаксация структуры аморфной сетки и ее упорядочение без какого-либо изменения состава и связывания атомов. Исследуемый температурный диапазон отжига широко используется для структурной стабилизации и улучшения характеристик аморфных пленок [8].

2) Температура отжига $T_A = 350\text{--}650^\circ\text{C}$. В результате вакуумного отжига в этом температурном диапазоне наблюдается уменьшение интегральной интенсивности колебательной моды растяжения (Si-H_n) связей и соответственно числа этих связей, а также концентрации связанного в пленке водорода до значений, меньших $5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$.

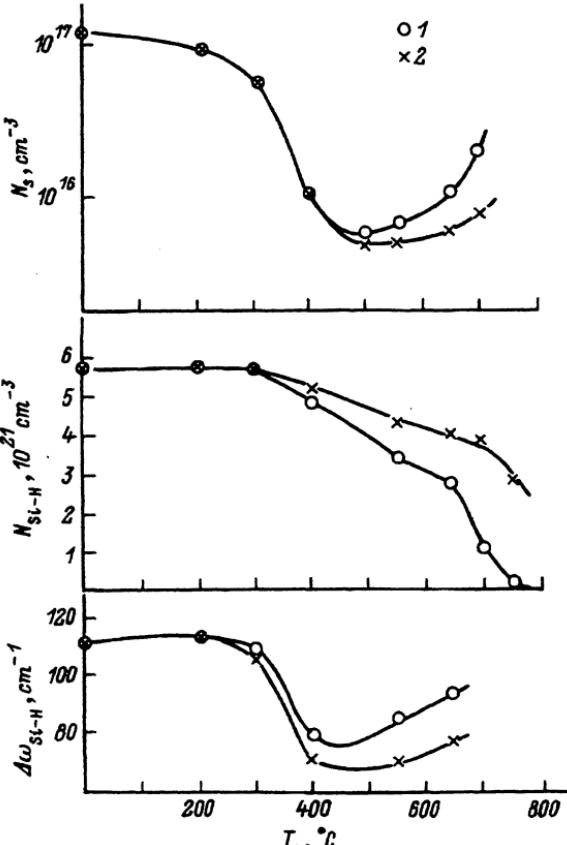


Рис. 1. Плотность спинов N_s , концентрация $N_{\text{Si}-\text{H}}$ и полуширина $\Delta\omega_{\text{Si}-\text{H}}$ полосы поглощения (Si-H) связей.

1 — вакуум, 2 — плазма.

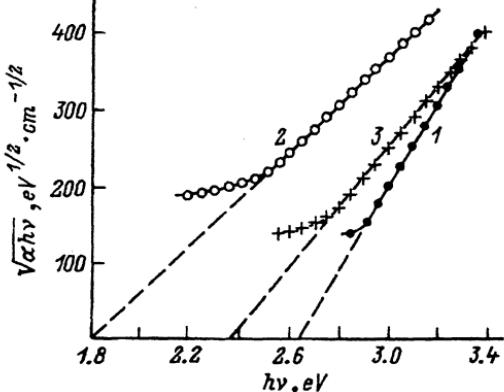


Рис. 2. Спектры поглощения пленок $\alpha\text{-Si}_{0.5}\text{C}_{0.5}\text{:H}$ (1), отожженных в вакууме (2) и водородной плазме (3) при 600° C .

Максимум вышеупомянутой полосы поглощения ω^M сдвигается от 2120 до 2065 cm^{-1} , при этом значение 2120 cm^{-1} определяется колебаниями атомов кремния, связанных с атомами водорода в дигидридной конфигурации и расположенных на поверхностях полых объемов в пленках [9]. Связи ($\text{Si}-\text{C}$) и ($\text{Si}-\text{CH}_n$) остаются стабильными, концентрация углерода, согласно данным Оже-спектроскопии, остается неизменной. Полуширина полосы поглощения на колебаниях ($\text{Si}-\text{H}_n$) связей (мода растяжения) уменьшается от 100 до 80 cm^{-1} . Концентрация оборванных связей, согласно данным ЭПР, падает до минимального значения порядка $3 \cdot 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ при $T_A = 450^\circ\text{ C}$, а затем медленно возрастает. Показатель преломления n изменяется от 2.64 до 1.88 . Ширина оптической запрещенной зоны уменьшается от 2.6 до 1.8 eV , а коэффициент пропорциональности B в этой зависимости, связанный с протяженностью хвостов, возрастает (рис. 2).

Полученные результаты могут быть объяснены следующим образом. В этом температурном диапазоне наблюдается выход слабо связанныего водорода, выстилающего внутренние поверхности микропор. Процесс сопровождается их «схлопыванием», высвобождением атомов водорода с поверхности микропор и последующим их захватом на близлежащие оборванные связи. При температурах выше 450° C наблюдается выход из аморфной сетки сильно связанного в конфигурации ($\text{Si}-\text{H}$) водорода. Образующиеся таким образом оборванные связи могут замыкаться друг на друга либо сразу же, либо после некоторой структурной перестройки. В результате этого процесса их концентрация возрастает, а параметры пленки деградируют.

В этом температурном интервале проявляются различия между пленками, отожженными в вакууме и в водородной плазме.

После отжига пленок в водородной плазме положение максимума ω^M полосы поглощения на колебаниях ($\text{Si}-\text{H}$) связи остается практически постоянным либо немного увеличивается, указывая на доминирующую роль поверхностно-связанного водорода; полуширина этой полосы резко уменьшается до 65 cm^{-1} . Концентрация оборванных связей практически не меняется. Содержание водорода в пленках остается практически постоянным. Оптическая ширина зоны E_g^{opt} меняется примерно до 2.4 eV . Значение показателя преломления проходит через свое минимальное значение при $T_A = 450^\circ\text{ C}$, а затем увеличивает-

ся до значения, типичного для кристаллического карбида кремния — 2.64. Исследования структуры пленок методом дифракции рентгеновских лучей свидетельствуют о наличии начальных стадий процесса кристаллизации. Электрическая проводимость пленок падает до величины порядка $5 \cdot 10^{-14} \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$.

Полученные результаты могут быть объяснены следующим образом. В процессе отжига в водородной плазме происходит эффективная пассивация образующихся при отжиге оборванных связей. Сам же процесс отжига в водородной плазме можно представить в виде следующей последовательности процессов: а) структурная релаксация пленок с тенденцией к кристаллизации; б) разрыв ($\text{Si}-\text{H}_n$) связей и эфузия водорода; в) последующая структурная релаксация, сопровождающаяся уменьшением свободной энергии оборванных всязей и замыканием их друг на друга; г) эффективная пассивация оборванных связей атомами водородной плазмы. Далее эта последовательность повторяется. Происходящие в указанной последовательности процессы приводят к формированию некоторых упорядоченных областей, включенных в аморфную сетку. При этом оборванные связи выталкиваются на поверхность таких областей, где затем эффективно пассивируются. Таким образом, мы можем говорить о структурных и композиционных флуктуациях в пленках $a\text{-SiC:H}$, где упорядоченные квазикристаллические области сетки SiC с малой концентрацией водорода окружены разупорядоченными низкотемпературными SiC:H областями с низкой концентрацией водорода. Материал в упорядоченных областях обладает низкой плотностью локализованных состояний, хорошими оптическими и электрофизическими свойствами. Таким образом, можно говорить об улучшении приборного качества материала стехиометрического состава.

Подтверждением высказанного может служить факт получения структур с барьером Шоттки ($c\text{-Si}/a\text{-SiC:H/Pd}$) с удовлетворительными характеристиками после отжига в водородной плазме [10].

3) Температуры отжига T_A выше 650°C . Для этого диапазона типичен процесс разрыва ($\text{C}-\text{H}_n$) и ($\text{Si}-\text{CH}_n$) связей и наблюдается новая стадия эфузии водорода и структурной перестройки. Параметры пленок при вакуумном отжиге ухудшаются (рис. 1). После плазменного отжига оптические, структурные, электрофизические параметры слабо меняются. Это объясняется конкуренцией двух процессов. Первый — параметры структуры пленок деградируют вследствие разрыва ($\text{C}-\text{H}_n$) связей, второй — улучшение параметров и структуры пленки вследствие структурной перестройки и пассивации водородом плазмы. Вследствие реорганизации углеродных связей при увеличении температуры отжига можно ожидать дальнейшей структурной перестройки с переходом к поликристаллической структуре и улучшением характеристик материала.

В результате проведения отжигов в вакууме и в водородной плазме в широком диапазоне температур отжига могут быть сделаны следующие выводы.

Все характеристики пленок меняются вследствие структурной реорганизации и разрыва ($\text{Si}-\text{H}_n$) и ($\text{C}-\text{H}_n$) связей.

Различия между отжигами в вакууме и водородной плазме проявляются только при температурах выше 350° С.

При отжигах в водородной плазме при $T_A > 500^\circ$ С могут быть получены пленки с начальными стадиями кристаллизации, пригодные для микроэлектронных применений.

Предлагается гипотетическая модель процесса отжига $a\text{-Si}_{0.5}\text{C}_{0.5}\text{:H}$, в которой материал представлен в виде упорядоченных квазикристаллических областей, включенных в разупорядоченные области SiC с высоким содержанием водорода.

Работа частично поддержана USA Department of Defense.

Список литературы

- [1] Bullot J., Schmidt M.P. // Phys. Stat. Sol. 1987. V. 143. N 1. P. 324–411.
- [2] Liedtke S., Jahn K., Finger F., Fuhs W. // J. Non. Cryst. Sol. 1987. V. 97/98. N 5. P. 1083–1086.
- [3] Demichelis F., Crovini G., Pirri C.F., Tresso E., Giamello E., DellaMea G., // Phys. B. 1990. V. 170. N 1. P. 149–152.
- [4] Beyer W. // J. Non. Cryst. Sol. 1987. V. 97/98. P. 1027–1034.
- [5] Shimizu T., Kumeda M. // Amorphous Silicon and Related Materials / Ed. H. Fritzsche World Scientific Publishing Company, 1988. P. 633–655.
- [6] Коньков О.И., Трапезникова И.Н., Власенко М.П., Теруков Е.И., Виолина Г.Н. // ФТТ. 1992. Т. 34. N 1. P. 326–328.
- [7] Аверьянов В.Л., Федоров В.А., Ястребов С.Г. // ЖТФ. 1994. Т. 36. № 1. С. 103–117.
- [8] Физика гидрогенизированного аморфного кремния / Под ред. Дж. Джоунополуса и Дж. Люковски. М.: Мир, 1987. Т. 1.
- [9] Stein H.I., Myers S.M., Follstaedt D.M. // J. Appl. Phys. 1993. V. 73. N 6. P. 2755–2764.
- [10] Konkov O.I., Trapeznikova I.N., Terukov E.I. // 5th Intern. Conf. on SiC and Related Materials Washington, D.C., 1993. P. Mo C4.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
25 марта 1994 г.